

RFスパッタ装置 SP-3500R



使用できる基材の寸法は2インチ以下ですが、3個のターゲットを持っており、多層膜の連続成膜が可能です。スパッタリング用電源を追加する事により、複数ターゲットの同時使用が可能で、複合材の成膜が出来ます。酸素ガスの導入による反応性スパッタリングが可能です。

RFスパッタ装置SP-3500R仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄20分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ430mm×300mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台
○基板形状	2インチ 1枚
○膜厚分布	±15%以内
○ターゲット寸法	3インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	3
○基板回転	無し
○基板加熱	常温～400℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:350L/min 油拡散ポンプ:1200L/sec
○操作方法	手動
○ガス系統	マスフローコントローラ 2系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相5KVA 冷却水:25L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:3000mmW×2000mmD×1800mmH